

## 产品特性

- 提供完整的保护机制
- 集成功率 MOSFET 等效阻抗为 35mΩ /RSS(ON)
- 过温保护
- 过充电流保护
- 过放电流保护
- 负载短路保护
- 高精度电压检测
- 低功耗电流
- -工作模式: 1.0µA
- -掉电模式: 0.01μA
- 有电池反接保护功能
- 提供 DFN1x1-4L & SOT23-3L 封装

## 产品应用

- 智能穿戴设备
- TWS 蓝牙耳机

### 产品描述

HCR2691系列为单节锂离子 (Li+) 电池设计的过充及过放电压和过大负载电流的保护 IC. 它还包括一个短路保护功能,以防止过大的外部短路电流。HCR2691由两个电压检测器、参考单元、延迟电路、短路保护器、逻辑电路和 MOSFET 开关组成。当充电电压超过检测器阈值 VDET1 电平时为过充,MOSFET 开关将关闭。检测到过充后,当 VBAT电压下降到 "VREL1"电平以下,或是断开充电器与电池组的连接,並且 VBAT电压下降至 "VREL1"电平以下时,即可复位,MOSFET 开关即导通。当放电电压低于检测器阈值 VDET2 电平时为过放,MOSFET 开关会在一个内部固定延迟时间后关闭。HCR2691系列检测到过放电压后,将充电器连接到电池组时,当电池供电电压高于过放检测阈值时,MOSFET开关即导通。

过载电流保护由内置的过流检测器侦测, 而侦测到 过载电流时透过内部固定延迟时间后,MOSFET开关 将关闭,切断过载电流。

一旦检测到过电流,就可以通过将电池组从负载系统中移除才可打开 MOSFET 开关来复位。此外,短路保护器在外部短路电流的作用下会立即关断 MOSFET 开关没有内部固定延迟时间。





SOT23-3L

图 1. HCR2691封装外观图



## 封装脚位图



图 2. HCR2691封装脚位图 (顶部)

# 封装引脚功能描述

DFN1x1-4L	SOT23-3L	Pin Name	引脚功能描述		
1	2	ВАТ	电源电压的输入。		
2, 3	3	vss	接地, 将电池的负极端子连接到引脚。PCB 布线时请将引脚与 EPAD 连接起来。		
4	1	EB-	系统端的负极。 内部 MOSFET 开关将此端子连接到 VSS。PCB 布线时请使用较宽的布线连接引脚。		
EPAD(5)	-	VSS	芯片基板。 悬空或连接到 VSS。 建议连接 VSS 为佳。		

# 典型应用电路

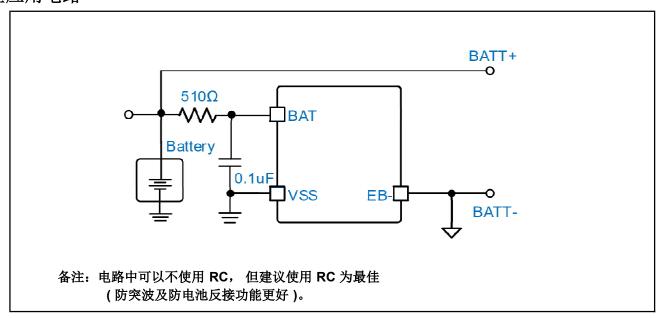


图 3. HCR2691典型应用原理图

产品规格书-V2 www.hcrsemi.com 页 2 / 9



# 产品功能方框图

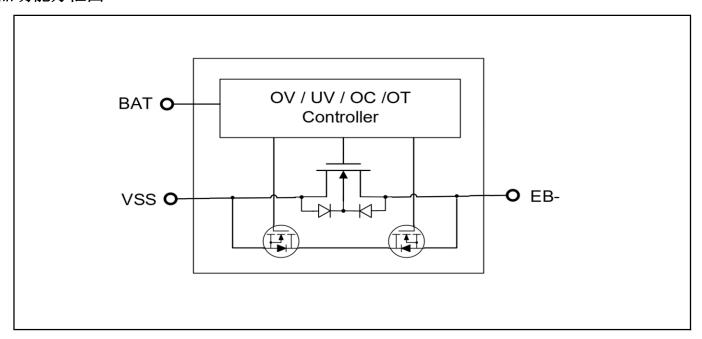
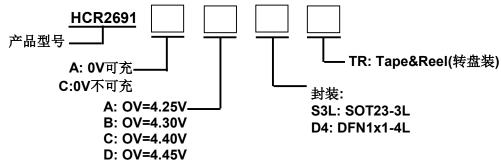


图 4. HCR2691功能方框图





## 产品订货信息

厂前り负行尽				
订货型号	丝印	温度范围	封装	每盘数量
HCR2691AAS3LTR	AAS3	-40'C to +85'C	SOT23-3L	3000个/盘
HCR2691ABS3LTR	ABS3	-40'C to +85'C	SOT23-3L	3000个/盘
HCR2691ACM3LTR	ACS3	-40'C to +85'C	SOT23-3L	3000个/盘
HCR2691ADM3LTR	ADS3	-40'C to +85'C	SOT23-3L	3000个/盘
HCR2691AAD4TR	AAD4	-40'C to +85'C	DFN1x1-4L	8000个/盘
HCR2691ABD4TR	ABD4	-40'C to +85'C	DFN1x1-4L	8000个/盘
HCR2691ACD4TR	ACD4	-40'C to +85'C	DFN1x1-4L	8000个/盘
HCR2691ADD4TR	ADD4	-40'C to +85'C	DFN1x1-4L	8000个/盘



# 最大耐压值 (Note 1)

参数项描述		符号	参数值	单位
输入电压范围从BAT到VSS		VBAT	-0.3 to +8	V
EB-脚电压范围从EB-到VSS		VEB-	-8 to +9	V
封装热阻 note2	DFN1x1-4L	θJΑ	195	'C/W
到表然阻	SOT23-3L	OJA	250	'C/W
结点温度		TJ	+150	'C
存储温度范围		Тѕтс	-65 to +150	'C
引脚焊锡温度 (Soldering, 10 sec.)		TLEAD	260	'C
ESD 静电		НВМ	2000	V
		ММ	200	V

Note 1. 任何超过"最大耐压值"的应用可能会导致芯片遭受永久性损坏。 这些是额定最大耐压值, 仅 表示在这个范围内芯片不会损伤, 但不保证所有性指标都正常, 在任何超过"最大耐压值"的 场合使用, 都可能导致芯片永久性损坏。 在接近或等于最大耐压值情况下使用, 可能会影响 产品可靠性。

2. θJA 测量条件: TA = 25°C.

## 建议应用条件

参数项描述	符号	最小	最大	単位
输入电压BAT	VBAT	1.5	5.5	V
应用结温范围	TJ	-40	+125	'C
应用环境温度范围	Та	-40	+85	Ċ

产品规格书-V2 www.hcrsemi.com 页 4 / 9



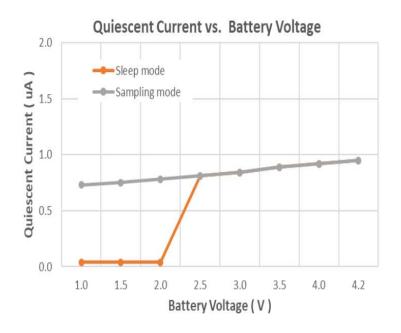
# 电气特性

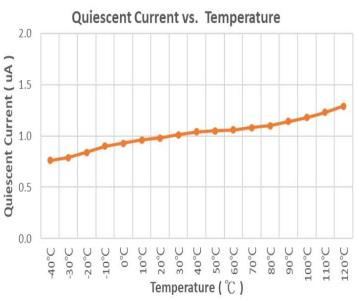
(VBAT =3.6V, TA=25°C 另有说明除外)

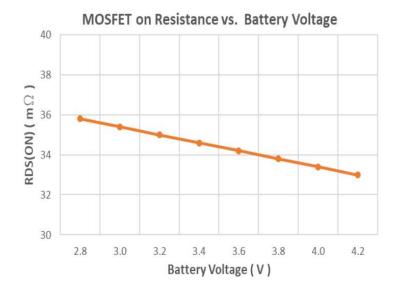
参数项描述	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
检测电压							
		OV Type A	4.225	4.25	4.275		
过充电保护电压	VDET1	OV Type B & E	4.275	4.30	4.325	v	
及元电体扩电压	VDEIT	OV Type C	4.375	4.40	4.425		
		OV Type D	4.425	4.45	4.475		
		OV Type A	4.025	4.05	4.075		
过充电解除电压	VREL1	OV Type B & E	4.075	4.10	4.125	V	
<b>过</b> 几七件你 七压	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	OV Type C	4.175	4.20	4.225	•	
		OV Type D	4.225	4.25	4.275		
过放电保护电压	VDET2	UV Type A & B	2.475	2.5	2.525	V	
	<b>V</b> DE12	UV Type C & D & E	2.775	2.8	2.825	v	
过放电解除电压	VREL2	UV Type A & B	2.675	2.7	2.725	V	
	11122	UV Type C & D & E	2.975	3.0	3.025		
检测电流							
过放电电流保护	lodd	VBAT=3.6V	0.2	0.4	0.6	Α	
过充电电流保护	locd	VBAT=3.6V	0.15	0.35	0.55		
负载短路电流保护	ISHORT	VBAT=3.6V	0.8	1.0	1.2	Α	
正常工作电流	ЮР	VBAT=3.6V, VEB- =0V	-	1.0	2.0	uA	
休眠待机电流	IDN	VBAT=2.0V, VEB- =Floating	-	0.01	0.1	uA	
内部功率MOSFET阻抗(Vss to Veb-	)						
功率MOSFET阻抗	RDS(ON)	VBAT=3.6V, IEB- =0.1A	-	35	49	mΩ	
过温保护			•				
过温保护检测	TSD	-	-	125	-	'C	
解除过温保护	TSDR	-	-	105	-	'C	
延迟时间							
过充电保护延时	tVDET1	-	140	180	220	mS	
过放电保护延时	tVDET2	-	35	45	55	mS	
过放电流保护延时	tlodd	-	8	10	12	mS	
过充电流保护延时	tlocp	-	8	10	12	mS	



# 典型电气特性:







产品规格书-V2 www.hcrsemi.com 页 6 / 9



## 应用指导:

过充电检测(VOCD)

VOCD 由 VBAT 引脚监控电压。当 VBAT 电压从低值 超过 VOCD 的 VDET1 阈值时, VOCD 检测并关闭 MOSFET 开关。

检测到过充后, 有两种情况释放 VOCD。

第一. 是当充电器仍在连接中,而 VBAT 电压下降至 低于 "VREL1"的电平时。

第二. 种情况是当充电器与电池组断开连接且 VBAT 连接到负载时, 放电电流可以通过内部寄生二极 管给电池放电, 而当 VBAT 电平放电到 "VDET1" 以下时, Vocd 可以复位并再次打开MOSFET 开关。

### 过放电检测 (VODD)

VODD 由 VBAT引脚监控电压。当 VBAT 电压低于过放电检测阈值 VDET2 时,VODD 可以检测到过放电,内部 MOSFET 开关将被关闭。

在过放保护期间,为了释放 VODD,充电器必须连接到电池组。 当VBAT电压保持在过放电检测阈值 VDET2 以下时,充电电流可以流过内部放电控制 MOSFET的寄生二极管给电池充电,使 VBAT 电压上升到大于VREL2 电平值时,MOSFET再次导通。过放检测的保护延迟时间为 tVDET2 = 45ms(典型值)。 VBAT 电压必须持续低于 VDET2 的时间超过 tVDET2 才能使 VODD 发出信号以关闭放电控制的 MOSFET。

通过 VODD 检测到过放后,电源电流会下降至0.01μA,进入休眠状态,但只有休眠模式才有此功能。

### 过电流检测 & 短路保护(VEOC)

当内部MOSFET开关导通时,持续监控过流和短路保护检测。当导通电流上升到过流保护电流电平时,过流检测器开始工作,内部MOSFET开关将被关断。内部过流检测器的动作延迟时间是内部固定的,典型值为10ms。

而短路保护被触发后,内部 MOSFET开关将在较短的延迟时间(通常为 270μs)后关闭。

过电流检测 & 短路保护(VEOC)(con.)

在检测到过流或短路保护后,需要关断负载来消除过流或外部短路的原因后,可使内部MOSFET开关自动导通。自动导通侦测由过流检测器在EB-和VSS引脚之间内置一个典型值为 67KΩ 的下拉电阻作为侦测来源。

### 充电电流异常检测

如果充电电流保持大于过充电电流检测的阈值,并且时间超过过充电检测延迟时间,HCR2691将关闭控制MOSFET 并停止充电。 该动作称为异常充电电流检测。 在检测到异常充电电流后, 须移除充电器才能再次打开控制 MOSFET。

### 热散功率

持续工作时,IC 的结点温度不应超过其额定值。最大的热散功率取决于 IC 封装的热阻,PCB 布图,周围气流速率以及结点和环境温度的差异。

最大热散功率计算如下:

环温 TA=25°C, 使用 HCRSEMI PCB,

DFN1x1-4L 封装:

 $PD(Max) = (125^{\circ}C - 25^{\circ}C) / (195^{\circ}C/W) = 0.51W$ 

#### SOT23-3L 封装:

PD (Max) =  $(125^{\circ}C - 25^{\circ}C) / (250^{\circ}C/W) = 0.4W$ 

热散功率(PD)等于输出电流和 LDO 上的压降的乘积, 计算公式如下:

 $PD = IOUT2 \times RS(ON)$ 

### Layout 注意事项:

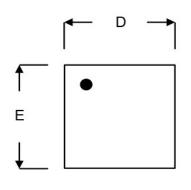
将输入电容和HCR2691 放置在 PCB 的同一面,并尽量将电容器靠近 IC 的输入输出脚摆放, 可实现电路最佳性能输入电容的接地连接必须拉回到HCR2691的接地引脚, 并使用短而粗的铺线连接。

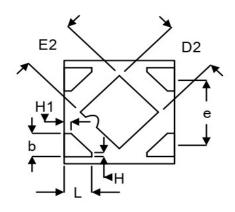


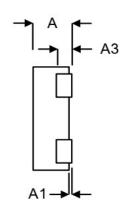
封装信息:

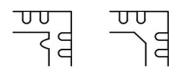
封装: DFN1x1-4L (D4)











**DETAILA**PIN #1 ID and Tie Bar Mark Options

Note: The configuration of the Pin #1 identifier is optional, but must be located within the zone indicated.

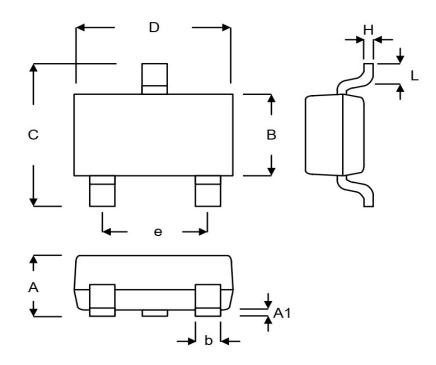
Symbol	Millim	eters	Inches		
Symbol	Min.	Max.	Min.	Max.	
Α	0.300	0.400	0.012	0.016	
A1	0.000	0.050	0.000	0.002	
А3	0.117	0.162	0.005	0.006	
b	0.175	0.280	0.007	0.011	
D	0.900	1.100	0.035	0.043	
D2	0.430	0.550	0.017	0.022	
Е	0.900	1.100	0.035	0.043	
E2	0.430	0.550	0.017	0.022	
е	0.650		0.026		
L	0.200	0.300	0.008	0.012	
Н	0.039		0.002		
H1	0.064		0.003		



封装信息(延续):

封装: SOT23-3L (S3L)

单位: mm



Symbol	Millim	neters	Inches		
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Α	0.900	1.150	0.035	0.045	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004	
В	1.200	1.400	0.047	0.055	
b	0.300	0.500	0.012	0.020	
С	2.250	2.550	0.089	0.100	
D	2.800	3.000	0.110	0.118	
е	1.900		0.0	75	
Н	0.080	0.150	0.003	0.006	
L	0.300	0.500	0.012	0.020	